

# ANMELDUNG

## SYSTEMS INTEGRATION

Intelligente Elektronik- und Mikrosensoriklösungen –  
Design, Entwicklung und Produktion  
Dienstag, 5. Oktober 2010

### Veranstaltungsort:

ESCHA Bauelemente GmbH  
Tel: +49 2353 708- 800  
D-58553 Halver

### Anmeldefax bitte an Alexia Hallermayer:

+49 (0) 231 / 97 42 -150

**Ich melde mich für die SYSTEMS INTEGRATION als Teilnehmer an.**

Die Tagungsgebühr beträgt 299 € bei Anmeldung bis zum 20.09.2010. Danach beträgt die Tagungsgebühr 319 €. Im Preis enthalten sind ein Tagungsband, Pausengetränke und Snacks.

**Ich bin IVAM-Mitglied melde mich für die SYSTEMS INTEGRATION als Teilnehmer an.**

Die Tagungsgebühr für IVAM-Mitglieder beträgt 269 € bei Anmeldung bis zum 20.09.2010. Danach beträgt die Tagungsgebühr 299 €. Im Preis enthalten sind ein Tagungsband, Pausengetränke und Snacks.

**Ich melde mich für die Führung bei der TURCK duotec an.**

Die Führung findet im Anschluss an die Veranstaltung statt und dauert etwa 30 Minuten.

**Ich melde mich für die Führung bei ESCHA Bauelemente an.**

Die Führungen beider Unternehmen der TURCK Gruppe können nacheinander wahrgenommen werden.

\_\_\_\_\_  
Titel, Vorname, Nachname

\_\_\_\_\_  
Firma/Rechnung

\_\_\_\_\_  
Rechnungsanschrift/Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
Email

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Bei Absage bis zum 20.09.2010 trotz verbindlicher Anmeldung wird eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 € berechnet, danach wird die volle Gebühr erhoben. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche Kosten möglich.

# ANFAHRT

## Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit dem Auto:

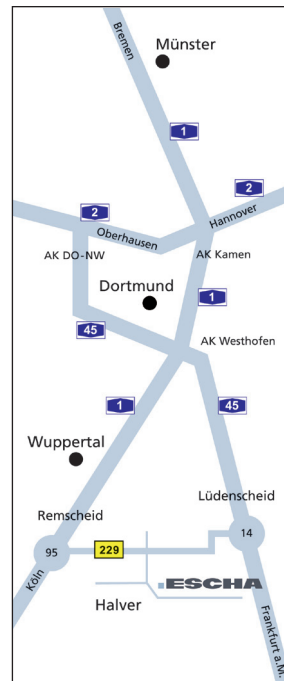
### Via A1

Sie verlassen die Autobahn A1 an der Ausfahrt Remscheid und folgen der Bundesstraße B229 Richtung Lüdenscheid. Nach 22 km biegen Sie an der Ampel rechts ab Richtung Halver. Linkerhand sehen Sie das Firmengebäude.

### Via A45

Von der Autobahn A45 Ausfahrt Lüdenscheid kommend, fahren Sie die Bundesstraße B229 in Richtung Halver, Hagen, Remscheid. In Halver biegen Sie an einer T-Kreuzung rechts ab und folgen der B229 Richtung Remscheid. An der zweiten Ampel biegen Sie nach links, Richtung Halver und sehen linkerhand das Firmengebäude.

Bei Fragen zur Anfahrt mit dem ÖPNV wenden Sie sich bitte an Alexia Hallermayer.

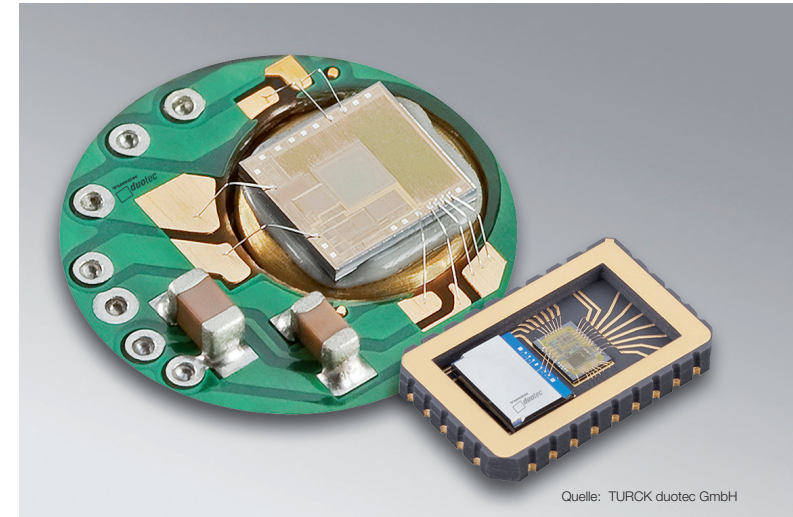


## Veranstaltungs-Adresse:

ESCHA Bauelemente GmbH  
Tel: +49 2353 708- 800  
D-58553 Halver  
Elberfelder Straße 32  
E-mail: info@escha.de  
Internet: www.escha.de

## Für Rückfragen wenden Sie sich an:

IVAM Fachverband für Mikrotechnik  
Alexia Hallermayer  
Tel.: +49 (0)231 9742-169  
Fax: +49 (0)231 9742-150  
E-mail: ah@ivam.de  
Internet: www.ivam.de



Quelle: TURCK duotec GmbH

## SYSTEMS INTEGRATION 5. OKTOBER 2010

Intelligente Elektronik- und  
Mikrosensoriklösungen –  
Design, Entwicklung und Produktion



## SYSTEMS INTEGRATION

Intelligente Elektronik- und Mikrosensoriklösungen –  
Design, Entwicklung und Produktion

### Sehr geehrte Damen und Herren,

intelligente Elektronik- und Mikrosensoriklösungen sind die Schrittmacher für den Fortschritt in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Prozessautomation, in der Automobilindustrie oder in der Medizintechnik. Das intelligente Zusammenspiel von Elektronik und Mikrosensorik ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, um drängende Zukunftsfragen, wie etwa nach energieeffizienter Produktion, umweltbewusster Mobilität oder nach einem zukunftsfähigen Gesundheitswesen zu beantworten.

Dabei geht es immer auch darum, Systeme anzubieten, die sich in einen Prozess oder in ein Produktumfeld gut integrieren lassen – deshalb heißt die Veranstaltungsreihe SYSTEMS INTEGRATION. Der Gastgeber des Symposiums, das Unternehmen TURCK duotec GmbH in Halver, entwickelt und produziert Elektronik und Mikrosensorik. In Verbindung mit den spannenden Gastbeiträgen von führenden Unternehmen aus der Mikrosensorik, der Automobil- und der Medizintechnik werden wir Trends in Design, Entwicklung und Applikationen vorstellen. Neben dem Fachprogramm können Sie sich bei der TURCK duotec GmbH und der Escha Bauelemente GmbH persönlich von den hochmodernen Produktionsmöglichkeiten im Rahmen einer Besichtigung überzeugen.

Der IVAM Fachverband für Mikrotechnik beschäftigt sich aktuell insbesondere mit Fragen, die sich um Energieeffizienz und nachhaltige Produktion drehen. Unter dem Namen „Green Microsystems“ (Green MST) zeigen wir Wege auf, wie mit konkreten Industrielösungen nachhaltiger und mit viel weniger Energieverbrauch produziert wird und energieeffiziente Produkte auf den Markt gebracht werden. Die TURCK duotec GmbH liefert hierzu viele wertvolle Beiträge in kundenspezifischen Projekten – neben Sensor- und Elektroniklösungen z.B. auch energieeffiziente LED Leuchtmittel. Organisiert wird die Veranstaltung vom IVAM Fachverband für Mikrotechnik und der TURCK duotec GmbH.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!



Dr. Ralf Behrensmeier  
TURCK duotec GmbH



Dr. Uwe Kleinkes  
IVAM Fachverband für  
Mikrotechnik

#### Veranstaltungsort:

**ESCHA Bauelemente GmbH**  
Elberfelder Str. 32  
58553 Halver

#### Veranstaltungsorganisation:

**IVAM GmbH**  
Emil-Figge-Str. 76  
44227 Dortmund  
Tel.: 0231 9742 169  
Fax: 0231 9742 150

# VERANSTALTUNGS-PROGRAMM

UHRZEIT	TAGUNGSPROGRAMM / THEMA	REFERENTEN
Dienstag, 05. Oktober 2010 10:30 Uhr	<b>Begrüßung</b>	<b>Werner Turck</b> / Turck Gruppe <b>Dr. Wilgart Schuchardt-Müller</b> Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen <b>Dr. Uwe Kleinkes</b> / IVAM Fachverband für Mikrotechnik
	<b>Session I:</b>	
10:40 Uhr	<b>Quo vadis Si-basierte Mikrosensorik? Stand, Systemanforderungen und Perspektiven</b>	<b>Dr. Olaf Brodersen</b> CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH
11:10 Uhr	<b>Integrierte Sensor Systemlösungen</b>	<b>Bernd Burchardt</b> ELMOS Semiconductor AG
11:30 Uhr	<b>Mikrosensorik für Automotive, Haus- und Gebäudetechnik, MEAS als MEMS-Foundry</b>	<b>Dirk Enderlein</b> MEAS Deutschland GmbH
11:50 Uhr	<b>Trends in der piezoresistiven Drucksensortechnologie</b>	<b>Peter Krause</b> First Sensor Technology GmbH
12:10 Uhr	Mittagspause	
	<b>Session II:</b>	
13:10 Uhr	<b>Intelligente Systemlösungen mit Mikrosensorik – Vom Design bis zum gehäuteten System</b>	<b>Dr. Ralf Behrensmeier</b> TURCK duotec GmbH
13:30 Uhr	<b>Autoklavierbare Umspritztechnik für Elektronik</b>	<b>Markus Born</b> Turck Delémont, Schweiz
13:50 Uhr	<b>Anwendungsspezifische Drucksensorik im Spannungsfeld zwischen Integration und Genauigkeit</b>	<b>Dr. Wolfram Beyer / Dr. Andreas Schroth</b> i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH
14:10 Uhr	Kaffeepause	
	<b>Session III:</b>	
14:50 Uhr	<b>3D-MID – Der Kunststoff verbindet Mechanik und Elektronik auf kleinstem Raum</b>	<b>Nouhad Bachnak</b> HARTING AG, Business Unit Mitronics, Schweiz
15:10 Uhr	<b>Einsatz von Sensoren in Orthopädietechnik zur Verbesserung der Anwendersicherheit</b>	<b>Erik Albrecht-Laatsch</b> Otto Bock HealthCare GmbH
15:30 Uhr	<b>Sensor-Wunschliste ans Christkind aus Sicht der Medizintechnik</b>	<b>Kai-Uwe Ritter</b> B. Braun Avitum AG
15:50 Uhr	Ende des Symposiums	
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr	<b>Führungen durch die Produktion</b>	Start Gruppe 1 Turck: 16:00 h / Start Gruppe 2 Turck: 16:30 h Start Gruppe 1 Escha: 16:30 h / Start Gruppe 2 Escha: 16:00 h